



## 意法半導體公布 2025 年第二季財報

- 第二季淨營收為 27.7 億美元，毛利率為 33.5%；營業損失為 1.33 億，包含與資產減損、重組費用及其他相關終止作業支出相關的 1.9 億美元；本期淨損為 9,700 萬美元
- 上半年淨營收為 52.8 億美元，毛利率為 33.5%；營業損失為 1.3 億美元，包含與資產減損、重組費用及其他相關終止作業支出相關的 1.98 億美元；上半年淨損為 4,100 萬美元。
- 第三季財測中位數預估：淨營收達 31.7 億美元，毛利率維持在 33.5%。

【臺北訊，2025 年 7 月 28 日】— 服務橫跨多重電子應用領域之全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱 ST；紐約證券交易所代碼：STM）公布截至 2025 年 6 月 28 日止之第二季依照美國通用會計準則（U.S. GAAP）編製的財報。

ST 第二季淨營收為 27.7 億美元，毛利率為 33.5%，營業虧損為 1.33 億美元，淨損為 9,700 萬美元，每股稀釋虧損為 0.11 美元。若以非美國通用會計準則計算，營業利益為 5,700 萬美元，淨利為 5,700 萬美元，每股稀釋盈餘為 0.06 美元。

意法半導體總裁暨執行長 Jean-Marc Chery 表示，「第二季淨營收高於財測區間中值，主因為個人電子與工業應用營收優於預期，而車用應用略低於預期；毛利率則與財測中值一致。與去年同期相比，第二季淨營收年減 14.4%，所有報告部門的營收皆呈現下滑，Non-U.S. GAAP 營業利益率由 11.6% 降至 2.1%，淨利由 3.53 億美元減至 5,700 萬美元。上半年淨營收年減 21.1%，non-GAAP 營業利益率為 1.3%，淨利為 1.2 億美元。第二季工業應用的訂單出貨比（book-to-bill ratio）仍高於 1，而車用則低於 1，整體訂單呈現季增。對於第三季，我們預期營收將達 31.7 億美元（以預測區間中值計算），年減 2.5%、季增 14.6%；毛利率約為 33.5%，其中包含約 340 個基點的閒置產能費用。就季變動而言，匯率影響為主，外加製造重整計畫的非經常性成本啟動，將使第三季毛利率下滑約 140 個基點。雖然預期第三季營收將呈現強勁的季增、持續改善年增表現，目前整體環境仍充滿宏觀經濟不確定性，因此接下來的重點將放在持續支援客戶、加快新產品推出，以及落實全公司製造據點重整與成本結構調整計畫。」

### 第二季財報重點

依照美國通用會計準則（U.S. GAAP） （單位：百萬美元，除每股盈餘外）	2025 年 第二季	2025 年 第一季	2024 年 第二季	季增 （Q/Q）	年減 （Y/Y）
淨營收	\$2,766	\$2,517	\$3,232	9.9%	-14.4%
毛利	\$926	\$841	\$1,296	10.2%	-28.5%
毛利率	33.5%	33.4%	40.1%	+10個基點	- 660個基點
營業利益（損失）	\$(133)	\$3	\$375	-	-
營業利益率	-4.8%	0.1%	11.6%	-490個基點	-1,640個基

					點
淨利 ( 損失 )	\$ (97)	\$56	\$353	-	-
稀釋後每股盈餘	<b>\$ (0.11)</b>	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.38</b>	-	-

非美國通用會計準則 ( Non-U.S. GAAP ) ( 單位：百萬美元，除每股盈餘外 )	2025 年 第二季	2025 年 第一季	2024 年 第二季	季增 ( Q/Q )	年減 ( Y/Y )
營業利益	\$57	\$11	\$375	429.6%	-84.7%
營業利益率	<b>2.1%</b>	<b>0.4%</b>	<b>11.6%</b>	<b>170個基點</b>	<b>-950個基點</b>
淨利	\$57	\$63	\$353	-9.1%	-83.9%
稀釋後每股盈餘	<b>\$0.06</b>	<b>\$0.07</b>	<b>\$0.38</b>	<b>-14.3%</b>	<b>-84.2%</b>

## 2025 年第二季重點回顧

提醒：自 2025 年 1 月 1 日起，本公司已調整業務部門分類方式。去年同期的比較數據亦已相應調整。

各報告部門淨營收 ( 單位：百萬美元 )	2025 年 第二季	2025 年 第一季	2024 年 第二季	季增 ( Q/Q )	年減 ( Y/Y )
類比產品、MEMS 與感測器 ( AM&S ) 部門	1,133	1,069	1,336	5.9%	-15.2%
功率與離散元件 ( P&D ) 部門	447	397	576	12.9%	-22.2%
小計：類比、功率與離散元件、MEMS 與感測器產品 ( APMS ) 產品群	<b>1,580</b>	<b>1,466</b>	<b>1,912</b>	<b>7.8%</b>	<b>-17.4%</b>
嵌入式處理 ( EMP ) 部門	847	742	906	14.1%	-6.5%
射頻與光通訊 ( RF&OC ) 部門	336	306	410	10.1%	-17.9%
小計：微控制器、數位 IC 與射頻產品 ( MDRF ) 產品群	<b>1,183</b>	<b>1,048</b>	<b>1,316</b>	<b>13.0%</b>	<b>-10.1%</b>
其他	3	3	4	-	-
總淨營收	<b>\$2,766</b>	<b>\$2,517</b>	<b>\$3,232</b>	<b>9.9%</b>	<b>-14.4%</b>

第二季營收達 27.7 億美元，年減 14.4%。來自 OEM 與代理商的年營收分別下滑 15.3% 與 12.0%。與前一季相比，營收季增 9.9%，高出 ST 財測區間中值 220 個基點。

毛利為 9.26 億美元，年減 28.5%；毛利率為 33.5%，略高於公司財測中值 10 個基點，年減 660 個基點，主因為產品組合改變、生產效率降低，以及閒置產能所產生的費用上升（影響相對較小）。

營業利益由去年同期的 3.75 億美元轉為本季營業虧損 1.33 億美元；營業利益率由 2024 年第二季的 11.6%，下滑至 -4.8%，年減 1,640 個基點。本季營業虧損包含 1.9 億美元的資產減損、重整費用與其他相關關廠成本，主要反映 ST 先前公告的全公司製造據點重整與全球成本結構調整計畫。

以各報告部門劃分，與去年同期相比：

類比、功率與離散元件、MEMS 與感測器 ( APMS ) 產品部

類比產品、MEMS 與感測器 ( AM&S ) 產品線：

- 營收年減 15.2%，主要反映類比產品的銷售下滑。

- 營業利益大幅減少 55.9%，至 8,500 萬美元。營業利益率為 7.5%，低於去年同期的 14.5%。

功率與離散元件 ( P&D ) 產品線：

- 營收年減 22.2%。
- 營業利益由 6,100 萬美元轉為虧損 5,600 萬美元。營業利益率為 -12.5%，去年同期為 10.6%。

微控制器、數位 IC 與射頻產品 ( MDRF ) 產品部

嵌入式處理 ( EMP ) 產品線：

- 營收年減 6.5%，主要受到客製化處理業務下滑影響。
- 營業利益減少 8.7%，至 1 億 1,400 萬美元。營業利益率為 13.5%，略低於去年同期的 13.8%。

射頻與光通訊 ( RF&OC ) 產品線：

- 營收年減 17.9%。
- 營業利益下滑 37.2%，至 6,000 萬美元。營業利益率為 17.9%，去年同期為 23.4%。

淨利與稀釋後每股盈餘分別轉為虧損 9,700 萬美元與每股虧損 0.11 美元，對比去年同期分別為淨利 3.53 億美元與每股盈餘 0.38 美元。以非美國一般公認會計原則 ( Non-U.S. GAAP ) 計算，2025 年第二季淨利為 5,700 萬美元，稀釋後每股盈餘為 0.06 美元。

### 現金流與資產負債表重點

單位：百萬美元	近 12 個月					
	2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季	2025 年第二季	2024 年第二季	年增變化
營業現金流	354	574	702	2,332	4,922	-52.6%
自由現金流 ( Non-U.S. GAAP )	(152)	30	159	142	1,384	-89.7%

第二季來自營業活動的淨現金為 3.54 億美元，去年同期為 7.02 億美元。

第二季的資本支出淨額 ( Non-U.S. GAAP ) 為 4.65 億美元，去年同期為 5.28 億美元。

自由現金流 ( Non-U.S. GAAP ) 為負 1.52 億美元，去年同期為正 1.59 億美元。

截至第二季末，庫存金額為 32.7 億美元，前一季為 30.1 億美元，去年同期為 28.1 億美元。季末存貨週轉天數為 166 天，前一季為 167 天，去年同期為 130 天。

第二季，ST 向股東發放現金股利總額為 8,100 萬美元，並依據現行庫藏股計畫回購自家股票 9,200 萬美元。

截至 2025 年 6 月 28 日，ST 的非美國通用會計準則 ( Non-U.S. GAAP ) 淨財務部位為 26.7 億美元，較 2025 年 3 月 29 日的 30.8 億美元減少。同期公司擁有總流動資金 56.3 億美元，以及總財務負債 29.6 億美元。考量尚未發生資本支出的資本補助預付款對流動資金的影響後，調整後的淨財務部位 ( Non-U.S. GAAP ) 截至 2025 年 6 月 28 日為 23.1 億美元。

## **未來展望**

意法半導體對 2025 年第三季的財務預估如下 ( 以區間中值計 )：

- 預估淨營收為 31.7 億美元，季增 14.6%，誤差範圍為正負 350 個基點。
- 預估毛利率為 33.5%，誤差範圍為正負 200 個基點。
- 此預測係以 2025 年第三季約 1 1 歐元兌 1.14 美元的有效匯率為基礎，並已反映現有避險合約的影響。
- 本季財報結算日為 2025 年 9 月 27 日。

本財務展望未納入未來若全球貿易關稅政策變動所可能產生的影響。

## **補充性非美國通用會計準則 ( Non-U.S. GAAP ) 財務資訊之使用說明**

本新聞稿內容包含補充性的非美國通用會計準則 ( Non-U.S. GAAP ) 財務資訊。

提醒讀者注意，這些財務數據尚未經審計，亦非依照美國通用會計準則編製，因此不應視為美國通用會計準則財務指標的替代參考。此外，此類非美國通用會計準則財務資訊，可能與其他公司使用同類名稱之資訊無法直接比較。為彌補上述限制，這些補充性財務資訊應與 ST 依照美國通用會計準則編製的合併財務報表一併參閱，不應單獨解讀。

關於 ST 非美國通用會計準則財務指標與對應美國通用會計準則財務指標的對帳資訊，請參閱本新聞稿附錄。

## **前瞻性資訊聲明**

本新聞稿中部分非屬歷史事實的敘述，為根據 1933 年《美國證券法》第 27A 條與 1934 年《美國證券交易法》第 21E 條 ( 均經修訂 ) 所定義的前瞻性聲明。這些聲明是根據本公司管理階層目前的看法與假設所做出，並涉及已知與未知的風險與不確定性，可能導致實際結果、表現或事件與此類聲明所預期的情況有顯著差異。影響因素包括但不限於：

- 全球貿易政策的變化，包括關稅與貿易障礙的新增與擴大，可能影響整體宏觀經濟情勢，進而直接或間接衝擊對本公司產品的需求；
- 宏觀經濟與產業趨勢的不確定性 ( 例如通貨膨脹與供應鏈波動 )，可能影響本公司產能與終端市場對產品的需求；
- 客戶需求與預測不符，可能使本公司需採取轉型措施，而這些措施未必能如預期帶來預期效益；

- 能否在技術迅速演進的環境中持續設計、製造並銷售具創新性的產品；
- 我們、本公司客戶或供應商營運所在地的經濟、社會、公共衛生、勞動、市政建設或政治條件變化，例如因整體經濟或區域事件、地緣政治與軍事衝突、社會動盪、勞工抗爭或恐怖活動所導致者；
- 出乎預期的事件或情勢，可能影響本公司執行計畫與／或達成研發與製造計畫目標的能力，而這些計畫係受惠於公共資金的支持；
- 本公司主要代理商發生財務困難，或關鍵客戶大幅縮減採購規模；
- 本公司生產設施的稼動率、產品組合與製造效能，以及履行與供應商或第三方製造商所保留產能所需的出貨量；
- 營運所需之設備、原物料、公用事業資源、第三方製造服務與技術，或其他供應品的可得性與成本（包括因通膨導致的成本上升）；
- 資訊系統的功能與效能，該系統支援製造、財務與銷售等關鍵營運活動，亦面臨資安威脅，以及本公司或客戶、供應商、合作夥伴與第三方授權技術提供者之資訊系統遭入侵的風險；
- 有關員工、客戶或其他第三方的個人資料遭竊取、遺失或不當使用，以及違反資料隱私法規的情況；
- 競爭對手或其他第三方提出的智慧財產權主張所造成的影響，以及本公司能否在合理條件下取得所需授權；
- 因稅法修訂、新制定法規、稅務查核結果，或國際租稅協定變更，導致整體稅務狀況出現變化，進而影響營運結果，以及正確評估稅額抵減、優惠、扣除與提列準備金的能力，並能否如期認列遞延所得稅資產；
- 外匯市場波動，特別是美元兌歐元及其他主要營運貨幣的匯率變動；
- 既有訴訟案件的結果，以及未來如成為被告所可能面臨的新訴訟所帶來的影響；
- 產品責任或保固相關索賠，包含因疫情或交貨失敗引發的索賠，或其他與本公司產品有關的訴訟，以及客戶針對含有本公司零組件產品所發起的召回行動；
- 天災等自然事件，例如嚴重天候、地震、海嘯、火山爆發或其他天然災害，以及氣候變遷的影響、健康風險與本公司、客戶或供應商所在地的流行病或疫情；
- 產業中日益增多的法規與政策倡議，包含關於氣候變遷與永續發展的相關議題，以及本公司致力於在直接與間接排放（範疇一與範疇二）、產品運輸、差旅與員工通勤排放（範疇三重點項目）全面達成碳中和目標，並在 2027 年底前全面使用再生電力的目標；
- 傳染病或大流行疫情，可能對全球經濟造成長期且重大的負面影響，進而對本公司的業務與營運成果產生重大不利影響；
- 產業結構變動，例如供應商、競爭對手與客戶之間的垂直整合或水平整併所帶來的影響；
- 新專案的順利量產進程，其成功與否可能受限於本公司無法掌控的因素，包括關鍵第三方元件的可用性，以及分包商是否能符合本公司預期之效能；
- 個別客戶對特定產品的實際使用情境可能與預期用途不同，導致效能表現（如能源使用量）出現差異，進而影響本公司既有的減碳目標，甚至可能引發法律爭議或產生額外的研究成本。

本新聞稿所載之前瞻性陳述，均涉及各項風險與不確定性，實際結果與本公司業務表現可能與此等前瞻性陳述有所差異，甚至產生重大不利影響。部分前瞻性陳述可透過以下用語辨識，例如：「相信」、「預期」、「可能」、



「預估將」、「應當」、「有望」、「尋求」、「預見」等，或是其他類似表達方式，亦可能以否定語氣或變化型出現，或透過對策略、計畫或意圖之描述呈現。

上述風險因素部分已載於本公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度，依據美國證券交易委員會 ( SEC ) 規定提交之 20-F 表格年度報告中「項目三：關鍵資訊 - 風險因素」章節，並有更詳細說明。若上述任一風險或不確定性發生，或所依據之基礎假設不正確，實際結果可能與本新聞稿中所述之預期、信念或推估情形有重大差異。本公司無意亦不承擔任何義務，就本新聞稿所提及之產業資訊或前瞻性陳述，因事後事件或情勢變動而進行更新或修正。

上述因素或本公司不時於提交美國證券交易委員會 ( SEC ) 文件中「項目三：關鍵資訊 - 風險因素」所列之其他因素，如出現不利變化，均可能對本公司之業務或財務狀況造成重大不利影響。

### 關於意法半導體

意法半導體 ( ST ) 擁有約 50,000 名專業人士，專注於半導體技術的設計與製造，並透過先進的生產設施掌握完整的供應鏈運作。作為一家垂直整合製造商，ST 與超過 200,000 家客戶與數千個合作夥伴緊密合作，攜手打造產品、解決方案與技術生態系，致力於共同拓展創新機會並面對技術挑戰，同時邁向更永續的未來。公司的技術廣泛應用於智慧交通、電力與能源管理優化，以及雲端連網自主裝置的規模化部署。我們正積極朝碳中和目標邁進，涵蓋範疇一與範疇二的所有直接與間接排放，並聚焦於產品運輸、差旅與員工通勤等範疇三排放。此外，ST 承諾在 2027 年底前全面達成 100% 使用再生電力的目標。更多資訊請參見：[www.st.com](http://www.st.com)。